

LOGICOM

REPAIR MANUAL/MANUEL DE RÉPARATION

POSH 405

Tools to be prepared / Outils nécessaires

1. **Screwdriver** (Cross type)
2. **Tweezers** (deal with small components like FPC...)
- 3/4. **Crowbar/Plate** (slim plastic, to separate the case)
5. **Suction cup** (assist to open the screen)

1. **Tournevis** (type cruciform)
2. **Pincettes** (pour manipuler de petits composants comme les FPC...)
- 3/4. **Levier plastique/ Plaque** (plastique fin, pour séparer le boîtier)
5. **Ventouse** (pour aider à ouvrir l'écran)



Precautions / Précautions

1. Backup the data of the device
2. Disconnect from power supply and off the device
3. Wear anti-static cloth/garment, or release static from device

1. Sauvegarder les données de l'appareil
2. Débrancher l'alimentation électrique et éteindre l'appareil
3. Porter une protection antistatique ou décharger l'électricité statique de l'appareil

STEP ONE: Remove the battery cover and the battery ÉTAPE 1 : Retirer le cache et la batterie.

1. Take out the mobile phone and locate the fastening position for removing the battery cover.
2. Use the nail of your thumb to pry outward at the fastening position of the battery cover, while holding the upper part of the mobile phone firmly with your other hand.
3. From the fastening position, use your nail to pull outward until the battery comes off.

1. Sortez le téléphone portable et repérez l'endroit où retirer le cache de la batterie.

2. Utilisez l'ongle de votre pouce pour faire levier vers l'extérieur à l'emplacement de fixation du cache de la batterie, tout en maintenant fermement la partie supérieure du téléphone avec votre autre main.

3. À partir du point de fixation, tirez doucement vers l'extérieur avec votre ongle jusqu'à ce que la batterie se détache.



STEP 2: After removing the screws, separate the Case A and Case B.

ÉTAPE 2 : Après avoir retiré les vis, séparez le boîtier A et le boîtier B

Turn the screwdriver to the left until the screw can be removed, then repeat this method to unscrew the 6 screws one by one.

As shown in Figure, Using the plectrum(or opening tool) and insert it into the gap between the upper and lower cases from one corner. Slide the plectrum clockwise along the edge to disengage the housing.

Caution: When separating the housing, do not apply excessive force to prevent damage to internal components.

Tournez le tournevis vers la gauche jusqu'à ce que la vis puisse être retirée, puis répétez cette opération pour dévisser les 6 vis une par une.

Comme illustré sur la figure, utilisez le médiator (ou l'outil d'ouverture) et insérez-le dans l'espace entre les parties supérieure et inférieure du boîtier à partir d'un coin.

Faites glisser le médiator dans le sens des aiguilles d'une montre le long du bord afin de désengager le boîtier.

Précaution : Lors de la séparation du boîtier, n'exercez pas une force excessive afin d'éviter d'endommager les composants internes.



STEP 3: Disconnect the battery cable and pull the battery adhesive tabs to remove the battery.

ÉTAPE 3 : Déconnectez le câble de la batterie et tirez sur les languettes adhésives pour retirer la batterie

Start from the position shown in the figure and gently peel off the conductive fabric and Mylar upward. Note: Peel off gently to prevent tearing the FPC underneath.

First, take the soldering iron to pre-tin the FPC solder joints on the mainboard, then use the soldering iron to remove the FPC from the mainboard pads starting from the tinned position. The soldering temperature for lead-free solder wire is $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$.

First, take the soldering iron to pre-tin the FPC solder joints on the mainboard, then use the soldering iron to remove the FPC from the mainboard pads starting from the tinned position. The soldering temperature for lead-free solder wire is $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$.

Commencez à partir de la position indiquée sur la figure et décollez délicatement vers le haut le tissu conducteur et le film Mylar.

Remarque : Décollez avec précaution afin d'éviter de déchirer la nappe FPC située en dessous.

Commencez par utiliser le fer à souder pour pré-étamer les points de soudure de la nappe FPC sur la carte principale, puis servez-vous du fer à souder pour détacher la nappe FPC des pastilles de la carte mère, en partant de la zone pré-étamée.

La température de soudage recommandée pour le fil à souder sans plomb est de $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$.



STEP 4: Remove the speaker bracket, take off the speaker, LED, and camera, then remove the camera FPC.

ÉTAPE 4 : Retirez le support du haut-parleur, puis le haut-parleur, la LED et la caméra, puis retirez la nappe FPC de la caméra

1. Use tweezers to pry up from this position and remove the speaker bracket.

2. Use tweezers to pry up from this position and remove the speaker bracket.

3. First, take the soldering iron to pre-tin the FPC solder joints on the mainboard, then use the soldering iron to remove the FPC from the mainboard pads starting from the tinned position. The soldering temperature for lead-free solder wire is $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$.

1. Utilisez une pince à épiler pour faire levier à cet endroit et retirer le support du haut-parleur.

2. Répétez la même opération avec la pince à épiler pour retirer complètement le support du haut-parleur.

3. Commencez par utiliser le fer à souder pour pré-étamer les points de soudure de la nappe FPC de la caméra sur la carte principale, puis utilisez le fer à souder pour détacher la nappe FPC des pastilles de la carte mère à partir de la zone pré-étamée.

La température de soudage recommandée pour le fil à souder sans plomb est de $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$.



STEP 5: Disconnect the left/right speaker connectors and microphone connector, then remove the speakers and microphone assembly.

ÉTAPE 5 : Déconnectez les connecteurs des haut-parleurs gauche/droite et du microphone, puis retirez l'ensemble haut-parleurs et microphone

1. As shown in the figure, use a soldering iron to remove the LED and speaker from the FPC.

2. From the position shown in the figure, pull outward while pushing up the bottom of the mainboard with your fingers until the mainboard detaches from the buckle positions. Then, release the four buckles that secure the mainboard one by one, following the order from right to left and top to bottom.

1. Comme indiqué sur la figure, utilisez un fer à souder pour retirer la LED et le haut-parleur de la nappe FPC.

2. À partir de la position indiquée sur la figure, tirez vers l'extérieur tout en poussant le bas de la carte principale avec vos doigts jusqu'à ce que la carte se détache des points de verrouillage.

Ensuite, relâchez les quatre loquets qui fixent la carte principale un par un, en suivant l'ordre de droite à gauche et de haut en bas.



STEP 6: Remove the Bluetooth antenna and MIC, then peel off the defective main antenna.

ÉTAPE 6 : Retirez l'antenne Bluetooth et le microphone, puis détachez l'antenne principale défectueuse

1. Use a soldering iron to remove the Bluetooth antenna and MIC from the solder joints on the mainboard.

2. Remove the defective antenna: First, peel off the adhesive part at the gold finger position from the inner side, then slowly peel off the defective antenna from the outer side.

1. Utilisez un fer à souder pour retirer l'antenne Bluetooth et le microphone des points de soudure sur la carte principale.

2. Retirez l'antenne défectueuse : commencez par décoller la partie adhésive à l'emplacement des contacts dorés depuis l'intérieur, puis retirez lentement l'antenne défectueuse depuis l'extérieur.



STEP 7: Remove the earpiece from the front housing
ÉTAPE 7 : Retirez l'écouteur du boîtier avant

As shown in the figure, use tweezers to lift the earpiece slowly by inserting the tweezers from the bottom right side

Comme indiqué sur la figure, utilisez une pince à épiler pour soulever lentement l'écouteur, en insérant la pince depuis le coin inférieur droit.



Components List / Liste des composants



Item	<u>Component name (EN)</u>	<u>Nom du composant (FR)</u>
1	Keypad	Touches / Clavier
2	LCD	Ecran LCD
3	Receiver	Récepteur / écouteur
4	Bluetooth antenna	Antenne Bluetooth
5	Front housing	Boitier avant
6	Middle housing	Boitier moyen / arrière
7	Battery cover	Couvercle de la batterie
8	Screw	Vis
9	Speaker supporter assembly	Support du haut-parleur
10	Main lens	Objectif principal
11	Mic	Micro
12	DOME	Dôme
13	PCBA	Carte mère
14	LED	LED
15	HAC FPC	Nappe FPC HAC
16	LCD pad Mylar	Pastille
17	Screen conductive fabric	Tissu conducteur pour l'écran
18	Speaker	Haut-parleur
19	Rear camera	Caméra arrière